

6月16日(木)

コンベンションホール1 (4F)	コンベンションホール2 (4F)	D 会議室 (6F)	小展示ホール (2F)
<p>9:40~11:00</p> <p>切削加工(微細加工)</p> <p>座長 鹿志村一男(株)牧野フライス製作所)</p>	<p>9:40~11:00</p> <p>CAD/CAM/CAE</p> <p>座長 牟田芳喜(トヨタ自動車株)</p>	<p>9:40~11:00</p> <p>金型材料・表面処理</p> <p>座長 萩野雅章(株)ニチダイ)</p>	<p>10:00~12:00</p> <p>特別セッション</p>
<p>112 マイクロエンドミルによる超微細加工 遠藤孝政(日進工具株)</p> <p>113 マイクロレンズアレイ金型の超精密切削加工 鈴木亨、林偉民、大森整、渡邊裕(独)理化学研究所)</p> <p>114 光学解析に基づくLCD用導光体の開発 福井雅彦、神谷渚、大島豊(東京工科大学)</p> <p>115 コアレスリニアモータ駆動マシニングセンタによる高速微細加工 伊東正頼、西口敏隆(株)ソディックエンジニアリング)</p>	<p>212 加工ノウハウの自動データベース化技術の開発 仁戸田健吾、青山英樹(慶應義塾大学)</p> <p>213 モールド金型の非ソリッド対応機能 大井純一(日本ユニシス・エクセリユーションズ株)</p> <p>214 割出しFF加工ソフト「TiltMill」のご紹介 久保埜義孝(株)牧野フライス製作所)</p> <p>215 WorkNCによる電極レス直彫り加工の提案 佐藤哲也(株)セスクワ)</p>	<p>313 新温熱間鍛造型用マトリックスハイス 福元志保、関山孝明、安藤光浩(日立金属株)</p> <p>314 幅広い用途に対応する磨き性に優れたHPMシリーズ 遠山文夫、田村庸(日立金属株)</p> <p>315 PS処理材の基礎特性とその実用例 本田弘之(大同アミスター株)、塩田哲郎(大同特殊鋼株)</p> <p>316 温熱間鍛造型用PVDコーティングTribec 雅 井上謙一、井上健(日立金属株)</p>	<p>「産学連携による“新世代” 型技術への挑戦」</p> <p>司 会 白井健二(日本大学) 高谷裕浩(大阪大学)</p> <p>講演者 清水友治(岩手大学) 福井雅彦・板橋伸卓(東京工科大学) 京谷忠幸(株)ピーエムティー) 北岡賢治(クラスターテクノロジー株)</p>
<p>11:10~12:10</p> <p>切削加工(微細加工)</p> <p>座長 鹿志村一男(株)牧野フライス製作所)</p>	<p>11:10~12:10</p> <p>CAD/CAM/CAE</p> <p>座長 牟田芳喜(トヨタ自動車株)</p>	<p>11:10~12:10</p> <p>金型材料・表面処理</p> <p>座長 萩野雅章(株)ニチダイ)</p>	<p>(内容の詳細は別紙をご覧ください)</p>
<p>116 回転工具によるマイクロ非球面の超精密切削 鈴木浩文(神戸大学)、山形豊、大森整(独)理化学研究所)樋口俊郎(東京大学)、牧野俊清、吉田和史(株)長津製作所)</p> <p>117 リニアモーター駆動超精密加工機による非軸対称非球面加工 吉田和史、牧野俊清(株)長津製作所)、山形豊、大森整(独)理化学研究所)、鈴木浩文(神戸大学)、樋口俊郎(東京大学)、宗方睦夫、飯田克彦(株)ナノコントロール)</p> <p>118 エンドミル加工による表面テクスチャの精度評価 戸井田直仁、小林義和、白井健二(日本大学)、戸澤幸一(日産自動車株)</p>	<p>216 テンプレートモデルを用いたモールド金型の3次元構想設計について 橋口淳一(日立造船情報システム株)</p> <p>217 エンドミル加工面のサーフェスインテグリティ予測シミュレータの開発 笹原弘之、中迫雅弥、堤正臣(東京農工大学)</p> <p>218 3DCAD データを活用した鋳造用金型設計の効率化 武藤一夫(職業能力開発総合大学校)、下野光博、日高慶明(株)今西製作所)</p>	<p>317 耐チップング性に優れた冷間粉末ダイス鋼の開発(Vanadis4 Extra) 日原政彦、永島洋(ウッデホルム株)</p> <p>318 金型の寿命向上とつくりやすさを両立した次世代冷間ダイス鋼「SLD-MAGIC」 阿部行雄、久保田邦親、鳴海雅稔、扇原孝志、山岡美樹(日立金属株)、小松原周吾(日立金属工具鋼株)</p> <p>319 窒化処理における樹脂金型の離型性向上 八代浩二(山梨県工業技術センター)、堀越康弘、堀越弘也(株)カナック)</p>	

13:00~

<p>13:00~14:20 切削加工 座長 森重功一(電気通信大学)</p>	<p>13:00~14:00 CAD/CAM・鋳鍛造・ダイカスト 座長 白井健二(日本大学)</p>	<p>13:00~14:40 形彫り放電加工と新技術 座長 谷繁寿彦(株ソディック)</p>	<p>13:00~15:00 特別セッション</p>
<p>119 プレス金型構造部加工の加工時間短縮 齊藤勝、原田茂幸、久未正和(日産自動車株)</p> <p>120 低速高送加工による超深彫加工用ラジASMILの開発 左甲斐武久(株金型コンサル)、青木渉(株B.T.T)</p> <p>121 大型金型の段取り時間の削減 齋藤幸一(システム・スリーアール日本株)</p> <p>122 振動吸収チャックの性能評価 井原之敏、矢崎正信(大阪工業大学) 齋藤幸一(システム・スリーアール日本株)</p>	<p>219 鍛造金型寿命向上におけるCAE技術活用事例 高階優一、藤川真一郎、石原章(日産自動車株)</p> <p>220 ダイカスト金型デジタルエンジニアリングの適用事例について 田村庸、中津英司(日立金属株)、滝沢佐知雄、日吉洋平(日産自動車株)</p> <p>221 CAD属性情報を活用したダイカスト型製作デジタルプロセスの構築 本田一博、釜田弘、加治佐英輔、牟田芳喜(トヨタ自動車株)</p>	<p>320 形彫り放電加工における高速・高精度加工 藤田邦雄(株牧野フライス製作所)</p> <p>321 亜鉛電極による超硬合金の微細放電加工 南久、増井清徳、塚原秀和、萩野秀樹(大阪府立産業技術総合研究所)</p> <p>322 リニアモータ駆動形彫り放電加工機の精密加工事例 橋本剛(株ソディック)</p> <p>323 微細コネクタ、鍛造金型における形彫放電加工の最新制御技術と加工事例 原永志、榎田中、西尾政昭、浅井巖慶(三菱電機株)</p> <p>324 金属錯体反応の微細放電加工への適用 津田裕樹、佐野定男(株ソディック)、増井清徳、塚原秀和、南久(大阪府立産業技術総合研究所)</p>	<p>「人材育成と現場改善」</p> <p>司会 津久井伸一(宮津製作所株) 萩野雅章(株ニチダイ)</p> <p>講演者 川住春雄(日産自動車株) 桂功(株デンソー) 前川佳徳(大阪産業大学) 平井聖児(ものづくり大学)</p> <p>(内容の詳細は別紙をご覧ください)</p>
<p>14:30~15:50 超精密研削加工 座長 瀧口雅人(日産自動車株)</p>	<p>14:10~15:50 ダイカスト 座長 高谷裕浩(大阪大学)</p>	<p>14:50~15:50 CAD/CAM・プレス 座長 白井健二(日本大学)</p>	<p>15:10~17:10 特別セッション</p>
<p>123 超精密加工の加工事例 中元一雄、菅井誠、松本真一(株ソディック)</p> <p>124 小径レンズ金型の超精密ELID研削加工 大森整、林偉民、鈴木亨、渡邊裕(独)理化学研究所)</p> <p>125 ナノCAMを利用したELID研削によるFレンズ金型加工の試み 林偉民、大森整、鈴木亨、渡邊裕(独)理化学研究所)</p> <p>126 ELID研削法によるGRINレンズの超精密非球面加工 林偉民、渡邊裕、大森整、上原嘉宏、鈴木亨(独)理化学研究所)</p>	<p>222 ダイカストおも型用2層構造球状黒鉛鋳鉄の開発 菊地俊史、菅野利猛、姜一求(株木村鋳造所)</p> <p>223 高信頼性熱間ダイス鋼 井上幸一郎、大藤孝、市岡雄二、荒木利彦(大同特殊鋼株)</p> <p>224 高品位ダイカスト金型材料DAC-P、DAC-S 長澤政幸、山口基、井上啓治、片岡公太、田村庸(日立金属株)</p> <p>225 ダイカスト金型におけるゲート方案 江藤裕、吉田崇志、鈴木裕(九州工業大学)、石川義昭(豊産業株)</p> <p>226 ダイカスト主型の圧縮変形に関する調査 栢原芳郎(トヨタ自動車株)、古谷匡(日立金属株)</p>	<p>325 プレス金型設計における成形ブランク計算 池田宗弘、徳高敬浩、鰐淵好輝(倉敷機械株)</p> <p>326 プレス金型成形性見込み支援機能CADCEUS CXEXP-SHAPERのご紹介 二本柳慎一(日本ユニシス・エクセリュージョンズ株)</p> <p>327 バーチャル生産試作を駆使した試作期間の短縮 竹内宏司、伊藤潔、住真夫、小野陽子(日産自動車株)</p>	<p>「ここまでできる、最新実用型技術」</p> <p>司会 高橋一郎(独)理化学研究所) 森重功一(電気通信大学)</p> <p>講演者 小松道男(小松技術士事務所) 高橋一重(株富士テクニカ) 國分秀博(株シー・エム・エスジャパン) 牧野俊清(株長津製作所)</p> <p>(内容の詳細は別紙をご覧ください)</p>

<p>16:00~17:00</p> <p>超精密研削加工</p> <p>座長 滝口雅人(日産自動車株)</p>	<p>16:00~16:40</p> <p>金型溶接</p> <p>座長 津久井伸一(宮津製作所株)</p>	<p>16:00~16:40</p> <p>電子ビーム加工の最新技術</p> <p>座長 谷繁寿彦(株ソディック)</p>	
<p>127 小径レンズ金型のための電極レス ELID 研削システム 上原嘉宏、大森整、林偉民、渡邊裕(独)理化学研究所)</p> <p>128 マイクロレンズアレイ型の超精密加工 山本雄士、鈴木浩文(神戸大学)、沖野正(JST)、高坂慎治(三栄精工株)</p> <p>129 超音波援用研磨法によるマイクロ非球面型の超精密加工 鈴木浩文、河守良太、沖野正、土方祥雄、森脇俊道(神戸大学)、近藤光男、安田亀代司、日比倫夫(協伸産業株)</p>	<p>227 レーザー溶接による金型の製作と修理 クラウドスシュミット(DSILaser International)、藤原美昭(金型溶接テクニカルセンター)</p> <p>228 金型溶接 藤原美昭(金型溶接テクニカルセンター)</p>	<p>328 電子ビーム磨き装置による最新加工事例 虞戦波、井上基弘、松木大二、森岡雅雄(株ソディック電子)</p> <p>329 電子ビーム加工の最新技術と金型鏡面仕上げの適用 花井正博(多田電機株)</p>	
		<p>16:40~17:20</p> <p>積層造形</p> <p>座長 谷繁寿彦(株ソディック)</p> <p>330 簡易樹脂型を短期間で高精度に製作する新型シート積層式3次元造形機 LOM-SC800H と新材料の紹介 杉村学、野々山透(杉村精工株)</p> <p>331 光硬化性樹脂を用いた順送り型マイクロ成形装置による光成形 谷祐希、小林義和、白井健二(日本大学)</p>	